



会员服务

[会员登陆与申请](#)[会费查询](#)

机构信息服务

机构编号: 密码: [登录](#)

信息查询

专家信息查询

[查询](#)

个人会员查询

[查询](#)

2011中国电子制造与封装技术年会在深圳举行

发布时间: 2011-12-9 10:13:24 新闻来源: 电子制造与封装技术分会 发布者: wjw

中国电子学会电子制造与封装技术分会主办的2011中国电子制造与封装技术年会于2011年11月11-12日在深圳市哈尔滨工业大学深圳研究生院举行,来自全国各地的200多家单位的350余名代表参加了会议。中国电子学会副总监、电子制造与封装技术分会主任委员毕克允,中国电子学会副秘书长王玉生等有关领导出席了大会并致辞。毕克允主任委员在会上做了题为“中国制造与封装”的主题报告。大会开幕式由分会副主任委员兼秘书长高宏主持。

分会委员、哈尔滨工业大学深圳研究生院材料学院院长李明雨教授主持了学术报告大会。大会报告围绕“电子制造技术的发展与对策”的主题,包括李明雨教授、工信部第五研究所可靠性实验与分析中心市场部邱宝军部长、深圳信息技术学院信息技术研究所王文利博士、日东电子科技有限公司市场部史建卫副总经理、海能达通信股份有限公司SMT车固勇主任工程师等14位专家和学者分别做了题为“选择性加热技术在电子互联的应用”、“电子制造工艺分析及可靠性特点及保证方法”、“DFX在先进电子制造中的应用”、“焊接设备核心技术及性能评估方法”、“FPC组装工艺及其导致的DFM问题与对策”等特邀报告,内容涉及先进高功率LED封装技术、印制电路技术发展现状及发展趋势、真空气相焊接应用、PCB深孔电镀技术、印制电路焊盘测试、无铅焊接工艺、微尺度BGA、选择性加热技术、新能源、电子装联可靠性、DFX应用、焊接设备、FPC组装工艺等,旨在搭建一个了解国内外先进电子制造技术的窗口、交流国内外电子制造技术信息的平台,提高我国电子制造技术能力,解决电子制造产业发展技术瓶颈问题。本次会议共收到论文56篇,反映了当前电子封装技术和电子制造技术的发展状况,并全部入编论文集。